

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和2年4月2日(2020.4.2)

【公開番号】特開2019-204842(P2019-204842A)

【公開日】令和1年11月28日(2019.11.28)

【年通号数】公開・登録公報2019-048

【出願番号】特願2018-97828(P2018-97828)

【国際特許分類】

H 01 L 33/48 (2010.01)

H 01 L 21/301 (2006.01)

【F I】

H 01 L 33/48

H 01 L 21/78 Q

H 01 L 21/78 M

H 01 L 21/78 W

【手続補正書】

【提出日】令和2年2月10日(2020.2.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に発光素子が形成された半導体ウェーハを第1のテープに貼り付け、前記半導体ウェーハを複数の発光素子に分割する分割工程と、前記第1のテープを延伸することにより、前記複数の発光素子のそれぞれの発光素子の間の距離を拡張する拡張工程と、前記複数の発光素子のそれぞれの発光素子の間の距離が拡張された状態において、前記複数の発光素子を、前記第1のテープから第2のテープに転写する転写工程と、前記複数の発光素子を実装基板に接合する実装工程を含む発光素子の製造方法であって、

前記分割工程において、前記第1のテープとして、伸縮性のある基材部と糊層からなり、前記糊層が島状に分割されたものを用い、前記島状に分割された糊層に前記複数の発光素子を貼り付け、

前記第1のテープの前記糊層を島状に分割する方法は、前記糊層をブレードまたはレーザーにより切断するか、または前記基材部の上に印刷法若しくはディスペンス法により島状の糊層を形成することを特徴とする発光素子の製造方法。

【請求項2】

前記発光素子を前記実装基板にフリップチップボンディングすることを特徴とする請求項1に記載の発光素子の製造方法。

【請求項3】

前記第1のテープとして、前記基材部がポリ塩化ビニル(PVC)またはポリプロピレン(PP)からなるものを用いることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の発光素子の製造方法。